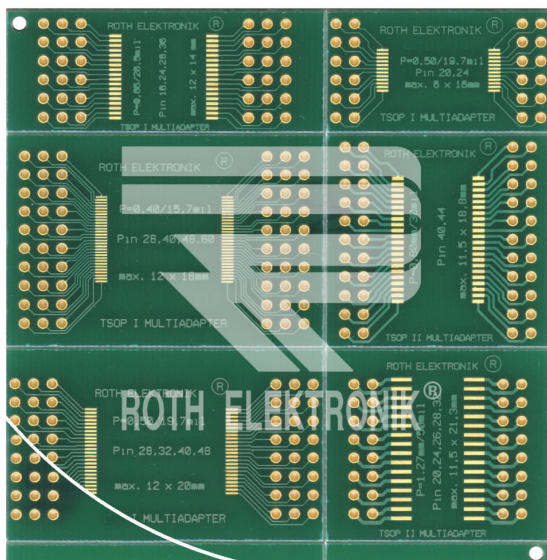


Multiadaptador SMD-TSOP I/II

RE900


- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- Lado de soldadura y de componetes con una superficie química de níquel/oro (Ni/Au) y una máscara de inhibidora de la soldadura
- distancia entre las zonas terminales:
0,40 mm (15.7 mil); 0,50 mm (19.7 mil); 0,65 mm (26.5 mil); 0,80 mm (30 mil);
1,27 mm (50 mil)
- agujeros de Ø 1,00 mm
- placa de circuito impreso de adaptación para 14 SMD TSOP I y 7 diferentes SMD TSOP II chips
- puntos de ruptura controlada prerrayados para separar módulos individuales de la placa de circuito impreso
- bajo demanda se ponen a disposición gratuitamente los datos Gerber para la fabricación de la impresión de pasta de soldar
- tamaño 72,60 x 76,20 mm

No.	Type	Pitch	Pin	Tamaño máx./mm
RE900-01	TSOP I	0,40	28,40,48,60	12 x 18
RE900-02	TSOP I	0,50	28,32,40,48	12 x 20
RE900-03	TSOP I	0,50	20,24	6 x 16
RE900-04	TSOP I	0,65	16,24,28,36	12 x 14
RE900-05	TSOP II	0,80	40,44	11,5 x 18,8
RE900-06	TSOP II	1,27	20,24,26,28,32	11,5 x 21,3